

H500-RB 抗RF系列

【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

应用特点：

- 柔软，可压缩性好
- 热阻抗较小
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能和耐高温性能

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

鸿富诚 H500-RB 导热硅胶垫片，是一款超高导热热界面材料。产品具有较好的电气绝缘特性及耐高温性能，产品防火性能高，能够较好地填充间隙，实现发热部件到散热部件之间的热传递。产品极具工艺性和使用性，是一种极佳的导热填充材料，被广泛应用于新能源产品中。

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	深灰色	---	目视
厚度	1~4	mm	ASTM D 374
硬度	35~50(± 5)	Shore C	ASTM D 2240
密度	2.0 ± 0.5	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥ 0.15	Mpa	ASTM D 412
延伸率	≥ 60	%	ASTM D 412
压缩比	≥ 20 (@50psi)	%	ASTM D 695
阻燃等级	V-0	---	UL-94
使用温度	-50~160	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	5.0 ± 0.5	W/m \cdot K	ASTM D 5470
热阻	≤ 0.6 (@20Psi/1mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

电学特性

体积电阻率	$\geq 10^{10}$	$\Omega\cdot\text{cm}$	ASTM D 257
介电常数	≥ 5	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤ 0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

